

WS715M FLUX LÍQUIDO SOLUBLE EN AGUA

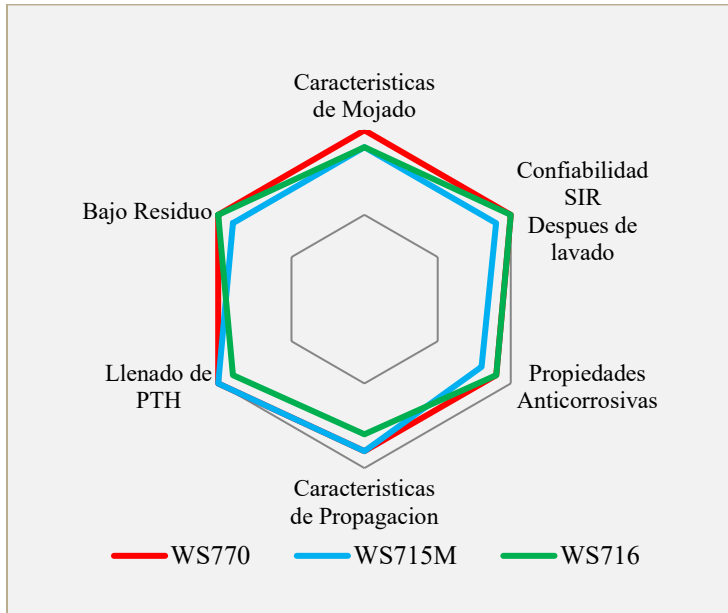
CUALIDADES

- Excelente Acción de Mojado
- Compatible con Aleaciones Estaño-Plomo y Libres de Plomo
- Fácil Limpieza con Agua Des-Ionizada
- Baja Generación de Espuma
- PH Neutro

DESCRIPCIÓN

WS715M es un flux líquido soluble en agua, base alcohol, libre de resina y orgánicamente activado, diseñado para aplicaciones de soldadura por ola y selectiva. WS715M puede ser aplicado por spray, espuma, inmersión o brocha. La fórmula del WS715M con ph neutro contiene un activador altamente durable que proporciona excelentes características de soldabilidad y mojado produciendo uniones de soldaduras uniformes y brillantes incluso en las superficies y acabados difíciles de mojar. WS715M se puede utilizar en todos los acabados superficiales comunes incluyendo ENIG, OSP y HASL. Los residuos de flux WS715M deben de ser removidos después del proceso de soldadura.

CARACTERÍSTICAS



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida Útil	1 año	Temperatura Ambiente

WS715M tiene una vida útil de un 1 año cuando se almacena a temperatura ambiente y sellado. No almacenar cerca de fuego o flamas. Mantener alejada de la luz solar, ya que puede degradar el producto. El flux liquido WS715M es enviado listo para su uso y aplicación, no requiere ser mezclado o diluido. No mezclar químicos usados y nuevos en el mismo contenedor. Volver a tapar o sellar cualquier contenedor abierto para su conservación. Se recomienda un rango de temperatura de 4°C - 40°C (40 - 100°F) para su almacenamiento.

APLICACION

WS715M puede aplicarse utilizando métodos de rociado, espuma, brocha o inmersión. WS715M está listo para usar directamente desde su envase, sin necesidad de diluirlo. Al aplicar el flux por rociado, es imprescindible lograr una cobertura adecuada y uniforme. Lo normal es aplicar una capa seca de flux de entre 500 y 1500 microgramos por pulgada cuadrada.

GUIA DE PROCESO

Utilizando termopares unidos a la parte superior del PCB, la temperatura debe estar entre 85-110 ° C (185-230 ° F) antes de tocar la soldadura. Es importante que el flux esté seco antes de entrar en contacto con la soldadura independientemente de la temperatura para evitar defectos. La generación de humo durante el proceso de soldadura puede ocurrir y se considera normal si no es excesivo. El tiempo de contacto recomendado depende de la configuración de la ola, la temperatura del crisol de soldadura, el tipo de aleación y la masa térmica del ensamblaje es de 3-8 segundos como típico. Para mayor información y asistencia en el proceso, comuníquese con el Soporte Técnico de AIM visitando: <https://www.aimsolder.com/contact>.

LIMPIEZA

Los residuos WS715M deben limpiarse con agua des-ionizada o en combinación con limpiadores apropiados. El agua des-ionizada se recomienda para el enjuague final. Se recomienda limpiar las placas en un plazo de 8 horas tras su procesamiento. Póngase en contacto con AIM para obtener más información.

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

SEGURIDAD

Utilizar con ventilación adecuada y equipo de protección personal adecuado. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información específica sobre emergencias. No deseche materiales peligrosos en contenedores no autorizados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nombre	Método de Prueba	Resultado
Clasificación de flux por IPC	J-STD-004	ORH1
Clasificación de flux por IPC	J-STD-004B 3.3.1	ORH1
Nombre	Método de Prueba	Resultado
Prueba de Corrosión Inducida por el Método Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	ALTO
Pruebas de Propiedades Corrosivas de los Residuos de Fundente	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	ALTO
Contenido de Haluros	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	>2.0
Presencia de Haluro(s) por Método de Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	Haluros Presentes
Presencia de Fluoruro(s) por Método de Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	Sin Fluoruros
Resistencia Aislante de la Superficie (SIR) * Medición en superficie limpia.	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA
	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	PASA
Contenido de Sólidos No Volátiles en el Fundente.	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	12.0 Valor Típico
Índice de Acidez del Flux	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	25.9 mg KOH por gramo de flux Valor Típico
Gravedad Específica	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0.80-0.85 (Agua= 1) Valor Típico
Inspección Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Claro, Incoloro
Mojado	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASA

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.